

北京屹唐半导体科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，围绕持续优化公司经营和加快创新发展、增强投资者回报、强化投资者沟通、进一步规范公司治理等方面，多措并举进一步提高公司发展质量，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

2026 年上半年，专项行动方案实施进展及成效如下：

一、聚焦主业，以创新引领公司高质量发展

根据国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）的统计数据，全球半导体设备市场（含前端晶圆制造及后端封测设备）在 2025 年达到创纪录的 1,351 亿美元，较 2024 年增长 15.4%；SEMI 预测全球半导体设备行业未来 3 年将持续增长，2026 年全球半导体制造设备销售额将达 1,659 亿美元，同比增长 23.2%，创历史新高；2028 年有望升至 2,295 亿美元，实现连续五年增长。

公司自成立以来，始终坚持致力于通过自主研发创新为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路设备，凭借多年持续自主研发与产品工艺积累，已形成包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀及等离子体表面处理设备在内的三类具有国际竞争力的成熟集成电路设备产品线。

作为同时具备等离子体和晶圆快速热处理国际领先技术的集成电路专用设备公司，公司不断完善研发管理机制和创新激励机制，持续加大研发投入，充分发挥核心技术优势，以研发驱动业绩增长，打造世界一流的产品及服务。

2026 年上半年，公司继续聚焦主业，做深做精主营设备产品，同时加快开发新品类、新产品，坚持自主创新，不断增强公司产品市场竞争力，并持续优化

公司运营管理，促进公司高质量、稳健、快速的发展，保持公司相关产品在全球以及国内集成电路设备行业的领先地位。具体包括以下方面：

（一）持续深耕主业，增强核心竞争力

公司通过持续研发投入，对现有干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备持续开展技术改进升级，不断提升产品的竞争力，保持产品先进性。报告期内，公司各产品线的产品研发及市场开发进展情况如下：

（1）干法去胶设备方面，公司开发推出的新一代先进干法去胶设备 Optima®系列产品可满足各类制程工艺需求，工艺效果优异，具备颗粒污染低、大规模量产综合持有成本低等卓越性能，该设备已成功导入存储器、逻辑、特色工艺集成电路等前道晶圆制造以及先进封装领域的多家客户并形成量产。与此同时，公司持续研发下一代高产能去胶设备，提升设备性能和效率，扩展工艺能力，并在此基础上进行新客户和新应用的拓展工作。

（2）快速热处理设备方面，公司借助在高温快速热处理、等离子体源及超高产出设备平台等领域的技术积累，已开展新的研发工作，包括开发新一代常压快速热处理设备全面提升现有设备性能，使其拥有更强的市场竞争力；开发先进低压快速热处理和氧化设备以及集成多项连续工艺流程的快速热处理一体化设备，以全面覆盖快速热处理领域各类制程需求；各项目均取得关键进展。

（3）干法刻蚀及等离子体表面处理设备方面，公司开发的新一代先进干法刻蚀设备 RENA-E®可以对离子能量和离子密度进行独立控制，具备刻蚀速度快、晶圆器件等离子体损伤小、器件性能表现优异、反应腔损耗品寿命长等各项卓越性能，还可以高效应对介质材料和金属材料的复杂膜层刻蚀。该设备已成功导入存储器、逻辑、特色工艺集成电路等前道晶圆制造领域的多家客户并形成量产，报告期内，该设备在多家国内新客户导入验证进展顺利，有效扩大了客户群体并获得了更多重复订单，新签订单层面开始进入逐渐放量阶段。此外，该设备具备在高带宽存储和先进封装领域的多种应用潜力，报告期内，公司在客户端应用拓展方面取得了积极进展，同类干法刻蚀设备亦已首次进入欧洲市场取得客户订单。公司将继续稳步推进对新客户及新应用的开发工作。

公司开发的先进等离子体表面处理和材料改性设备利用专利技术产生高浓度化学反应自由基，在低热预算下有效改善各种薄膜材料的性质和性能，广泛应用于存储器和逻辑半导体制造中金属薄膜电阻率降低，裂缝修复，增强金属薄膜选择性沉积，增强可流动化学气相沉积介质薄膜致密度等。该设备已成功导入海外先进存储器、先进逻辑领域的多家客户，报告期内，公司持续获得客户重复订单。国内团队自主研发的等离子体表面处理设备也在与头部客户的合作中取得了积极进展，公司持续推进新客户拓展及新应用的开发工作。

除了上述新产品之外，为了更好地满足国内外客户对于干法刻蚀及等离子体表面处理设备的广泛需求，进一步提升公司在干法刻蚀及等离子体表面处理设备领域的可服务市场规模，公司目前已开展新型金属刻蚀设备、新型晶边刻蚀和沉积设备、高选择比刻蚀设备及多腔体工艺集成平台设备等研发项目，均取得良好进展，部分项目于报告期内已完成产品研发并导入客户端开展验证。同时，公司在现有成熟稳定的刻蚀和去胶技术基础上，结合金属刻蚀工艺的需求和特点，开发了高竞争力、全覆盖后段刻蚀工艺需求的介质和金属刻蚀设备。目前，该产品工艺和客户应用开发进展顺利，在先进封装领域具备广阔的应用空间。

（二）坚持核心技术自主原创，不断加大研发投入力度

公司坚持自主原创和正向研发的理念，始终以核心技术的自主创新引领公司研发工作的开展，并持续加大研发投入力度。2026 年 1-6 月公司研发投入总额为 3.75 亿元，同比增长 2.35%，研发投入占收入的 17.61%。报告期内，公司新增专利申请 45 项，其中发明专利 45 项，占比 100.00%；公司新增授权专利 19 项，其中发明专利 19 项，占比 100.00%；公司新增获得软件著作权 4 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已申请专利 781 项，其中发明专利 779 项，占比 99.74%；已获授权专利 522 项，其中发明专利 520 项，占比 99.61%；已获登记的软件著作权 10 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员 398 人，占公司员工总数的 31.36%，其中国内研发人员 283 人，占研发人员总数的 71.11%。

（三）深入推进供应链本土化，加快产业链布局

公司高度重视提升集成电路设备及核心零部件供应链的安全性，积极拓展和协同上游供应商开展技术合作，共同推动相关零部件的技术验证与进步，从而加

快相关零部件项目的本土化进程，保证产品和技术的自主可控及供应链安全。

2026 年上半年，公司继续关注集成电路产业链本土化发展进展，持续加大力度参与支持、培育本土供应链优质企业。围绕干法去胶、干法刻蚀及等离子体表面处理设备、热处理设备等集成电路设备的量产需求，加快培育关键零部件的本土供应商，带动产业链上游协同发展。加快实施关键零部件的多厂供应策略，提升供应的相应速度，有力的保障了供应链安全。

（四）内生增长与外延并购并重，加快公司发展

公司致力于成为国际领先的集成电路设备公司，为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路专用设备。

公司坚持以内生增长为发展的基础。公司基于过去数十年积累的技术优势和客户关系，以客户需求为导向持续进行研发活动及业务拓展，采用差异化的研发策略，保持、提升公司在干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备领域的产品优势地位及市场竞争力，持续开发推出新产品，扩大产品组合及可服务市场规模，积极开拓国内外新客户，同时推动更多类型的产品切入现有客户的产线，提高市场份额。

公司同时重视采用投资、并购等方式实现外延式增长。公司于 2026 年上半年参与了恒运昌（股票代码：688785）以及中科仪（股票代码：920186）首发战略配售股票投资，扶持并巩固自身上游供应链安全。此外，公司也积极关注对集成电路设备商及上游供应商进行投资、并购的机会，力争扩大产品市场覆盖、优化产业生态，增强公司的综合竞争力。

二、持续优化运营管理，保障上市公司经营业绩

公司设备产品在逻辑芯片、存储芯片、专用芯片等制造领域已实现产业化应用，客户群体覆盖全球前十大芯片制造商和国内主流芯片制造商。报告期内，公司采取自主研发、自主创新模式，持续加大研发投入，提升产品技术优势和市场竞争力，扩大产品组合，并积极进行境内外市场开发及新产品导入，在手订单充足。受现有产品组合、订单结构及部分项目的交付节奏等阶段性因素影响，2026 年 1-6 月公司实现营业收入 21.31 亿元，同比下降 14.12%；得益于公司主营业务

毛利率的持续改善以及公司持有的其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益，归属于上市公司股东的净利润为 3.96 亿元，同比增长 13.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.43 亿元，同比下降 4.47%。公司高度重视运营管理能力的提升，通过组织各级人员培训并考核以提升工作效率、定期召开供应链本土化及技术优化工作协调会等多种措施构建了降本增效、持续增强盈利能力的管理文化。

2026 年下半年，公司将继续深入优化现有采购、物流、生产等内外部资源，进一步改善研发、采购和供应商管理、生产制造、物流、客户服务等各个环节和流程，通过提前布局前沿技术、优化完善供应商体系、推进精细化运营管理等措施，进一步提升企业管理水平，全面持续深化精细化管理，降低企业运营成本，不断提升经营业绩，保证公司持续高质量稳健发展。

三、重视股东投资回报，积极分享公司成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。在制度层面，公司在《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对利润分配的基本原则、分配形式、现金分红条件和比例以及利润分配的决策程序等作出了详细规定。

2026 年，公司积极落实以“投资者为本”的上市公司发展理念，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，向投资者进行了 2025 年度的现金分红。公司 2025 年年度股东会审议通过了每 10 股派发现金红利 0.273 元（含税）的利润分配方案，2026 年 6 月 26 日公司实施完成 2025 年度利润分配，共计派发现金红利 80,686,788.00 元（含税），占 2025 年公司合并报表归属于母公司股东净利润的 12.03%，切实与全体股东共享发展成果。

四、提升信息披露质量，建立多元化沟通体系

公司自上市以来按法律法规和公司相关制度的要求严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司的信息透明度。

（一）持续提升信息披露质量

2026 年上半年，公司继续严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等发布的有关法律法规和公司相关信息披露管理制度，严谨、合规地开展信息披露工作，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告和临时公告等重大信息，为股东进行投资决策提供信息基础。公司也进一步提高信息披露内容的系统性、可读性和易理解性，在公司披露 2025 年年度报告后适时发布可视化报告，并及时举行业绩说明会对 2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告内容进行解读，及时回应投资者提出的问题，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

此外，公司以创新为引领，多维度加强 ESG 工作的统筹与指导，全面提升 ESG 治理成效。报告期内，公司在 Wind ESG 评级和华证 ESG 评级中均获得 A 级，在商道融绿和秩鼎 ESG 评级中分别获得 A-和 AA 级。

（二）构建多元化的投资者沟通体系

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，积极搭建与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，通过公司官网投资者关系板块、上证 e 互动平台、投资者热线电话、投资者电子信箱、业绩说明会、股东会等多种渠道与投资者保持良好互动和沟通。

2026 年 5 月 15 日，公司通过上证路演中心组织 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，公司董事长、总裁兼首席执行官、三位独立董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书出席本次业绩说明会，就投资者关切进行及时和详尽的回答。

2026 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年年度股东会，在保障信息公平的情况下，公司董事及管理层与参会股东就年度股东会的议案、公司业绩进行了面对面交流。

2026 年上半年，公司通过上证 e 互动平台累计回复投资者问题 16 个；通过公司微信公众号发布 2025 年度可视化年度报告、2025 年度可视化可持续发展报告，便于广大投资者更直观地了解公司的关键信息。

五、进一步完善公司治理体系，持续提升公司治理水平

完善的治理结构与高效的内部控制体系对于公司的长远发展至关重要，公司建立了由股东会、董事会、董事会各专门委员会和管理层组成的公司治理体系，以确保权力分配和职责划分的清晰性，决策的合理性，以及监督和管理的有效性，从而实现不同层级治理机构间的良性互动和平衡。公司根据 2025 年最新修订的《上市公司治理准则》规定，于 2026 年上半年及时制定并发布了《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同时，公司保持对上交所、北京上市公司协会、中国上市公司协会等监管机构和自律组织发布的相关培训信息的关注，并及时组织董事、高级管理人员参加，以提升董事、高级管理人员的合规意识、自律意识以及履职能力。2026 年 1-6 月，公司董事、高级管理人员就 6 项培训合计参与 16 人次。

六、压实“关键少数”责任，实现利益风险共享共担

2026 年上半年，公司及时制定并发布了《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，更多地将高级管理人员薪酬架构与公司经营绩效挂钩，进一步增强高级管理人员与股东利益共享和风险共担。

公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行 2026 年度绩效考评，将高级管理人员薪酬结构更多地与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬结构与公司长远发展和股东利益相结合。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司的长期稳定发展。

七、持续评估完善行动方案，共同推动公司高质量发展

2026 年上半年，公司全面贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，在聚焦主业、提升公司核心竞争力和盈利能力、进一步推进供应链本土化、持续优化运营管理、股东回报、公司治理、投资者交流等方面均严格按照行动方案的具体举措执行并取得了较好的成效。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司也将继续聚焦主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能

力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

八、其他说明及风险提示

本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，该方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险，理性进行投资。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年8月27日